（上接B138版）

实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2022年公司向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号），同意公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]ID-0030号）。

2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》（立信中联验字[2023]ID-0025号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用及余额情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	序号	金额
募集资金专项账户到位金额	A	525,754,701.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	301,217,040.50
	节余募集资金补流	B2	0.00
	利息收入净额	B3	14,126,500.43
	支付发行费用	B4	565,000.00
本期发生额	项目投入	C1	49,884,600.95
	节余募集资金补流	C2	4,102,720.15
	利息收入净额	C3	2,564,460.26
	支付发行费用	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	351,101,641.45
	节余募集资金补流	D2=B2+C2	4,102,720.15
	利息收入净额	D3=B3+C3	16,691,056.69
	支付发行费用	D4=B4+C4	565,000.00
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	186,676,390.39
实际结余募集资金		F	186,676,390.39
差异		G=E-F	0.00

注：①补充流动资金实际投资金额为85,261,975.18元，超出募集前承诺投资金额790,277.07元，主要系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。②节余募集资金补流4,102,720.15元系2022年向特定对象发行股票募投项目之“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备”所节余资金，该项目已于2025年8月完成结项。

2、截至2025年12月31日，公司2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及余额情况如下表所示

单位：人民币元

项目	序号	金额
募集资金专项账户到位金额	A	1,135,000,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	284,780,091.74
	节余募集资金补流	B2	0.00
	利息收入净额	B3	23,289,772.94
	支付发行费用	B4	1,439,999.97
本期发生额	项目投入	C1	167,703,597.02
	节余募集资金补流	C2	0.00
	利息收入净额	C3	9,394,678.79
	支付发行费用	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	452,483,688.76
	节余募集资金补流	D2=B2+C2	0.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	32,684,451.73
	支付发行费用	D4=B4+C4	1,439,999.97
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	713,760,764.00
实际结余募集资金		F	713,760,764.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2022年8月，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称方正证券）担任公司2021年向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原持续督导机构平安证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2022年8月—11月，奥特维、子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维智能装备有限公司及方正证券与相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年2月，公司聘请平安证券担任公司向不特定对象发行可转债的保荐机构，并承接原持续督导机构尚未完成的持续督导工作，公司及相关子公司与原保荐机构方正证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2023年3月，公司、相关子公司及平安证券与相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月16日可转换公司债券募集资金全部到位，2023年8月—9月，公司、平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年11月，奥特维、子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司及平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，为更好的管理闲置募集资金，公司设立了募集资金理财产品专用结算账户，并于2023年12月，与平安证券、兴业银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年5月，奥特维、子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司、无锡普乐新能源有限公司、平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年7月，因控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司吸收合并事项，奥特维、控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司及平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行，相关协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的专户存储情况列示如下：

1、2022年公司向特定对象发行股票

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	初始金额	截至日余额
1	平安银行股份有限公司无锡分行	15239168881636	47,000,000.00	已注销
2	平安银行股份有限公司无锡分行	15279088851662	-	已注销
3	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100116881166	147,000,000.00	86,437,373.99
4	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100110004833	-	已注销
5	兴业银行股份有限公司无锡分行	408450100100246861	-	7,539,567.66
6	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100110888516	96,000,000.00	2,110,126.23
7	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100110888165	150,000,000.00	30,293,189.64
8	交通银行股份有限公司无锡锡阳支行	322000620013001020692	85,754,701.30	2.81
9	兴业银行股份有限公司无锡分行	408450100100258088	-	12,494,497.37
10	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100701357	-	32,466,163.13
11	兴业银行股份有限公司无锡分行	408450100100256910	-	15,334,800.66
合计			525,754,701.30	186,676,390.39

注：①2021年度公司向特定对象发行股票预案，该次发行于2022年8月22日完成。②截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为0.00元。

2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	初始金额	截至日余额
1	兴业银行无锡分行营业部	408410100100663689	595,000,000.00	505,956,664.96
2	中信银行无锡新区支行	8110601018802316896	180,000,000.00	122,979,949.86
3	招商银行新区支行	510903064810816	260,000,000.00	20,813.42
4	交通银行锡阳支行	322000620013001287795	60,000,000.00	49,811,210.96
5	中信银行梅村支行	8037975960901	40,000,000.00	28,104,240.84
6	中信银行无锡梅村支行	476780011773	-	已注销
7	中信银行无锡梅村支行	476780800342	-	6,887,884.19
合计			1,135,000,000.00	713,760,764.00

注：截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为0.00元。

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司募集资金投资项目的资金使用情况请详见附件附表一：2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表，附表二：2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表和附表三：变更募集资金投资项目情况表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年11月3日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常开展的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。

2025年10月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-106）。

公司在兴业银行股份有限公司无锡分行、中信证券股份有限公司无锡分公司、广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部等开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0.00万元。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年12月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额990.87万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了立信中联专审字[2022]D-0549号《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2025年6月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，具体详见公司在2025年6月25日披露于上海证券交易所网站的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。截至2025年12月31日，2022年公司向特定对象发行股票项目以及2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券项目针对上述事项，分别以募集资金置换累计金额为7,085.05万元、635.19万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月13日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2025-004）。

2025年12月12日，公司已将上述临时补充流动资金已使用的2.2626亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2025年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2025-121）。

2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年12月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2025-123）。截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年向特定对象发行股票募投项目之“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备”已于2025年8月完成结项，结余资金4,102,720.15元。公司于2025年8月25日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”予以结项并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2025年4月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及延期的议案》决定将“平台化高端智能装备智慧工厂”达到预定可使用状态时间由原计划的2025年5月延长至2026年3月，并对项目内部投资结构进行调整。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构以及延期的公告》(2025-038)。项目内部投资结构调整具体如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后		增减变动调整	调整后拟投入募集资金金额
		项目投资总额	投资占比	项目投资总额	投资占比		
一	建设投资	93,228.70	88.00%	93,228.70	88.00%	0.00	93,228.70
1	土建工程	81,641.50	77.06%	81,641.50	77.06%	0.00	81,641.50
2	配套设备购置及安装	6,871.80	6.49%	5,871.80	5.54%	-1,000.00	5,871.80
3	配套软件购置	2,000.00	1.89%	3,465.00	3.27%	1,465.00	3,465.00
4	基本预备费	2,715.40	2.56%	2,250.40	2.12%	-465	2,250.40
二	铺底流动资金	12,713.20	12.00%	12,713.20	12.00%	0.00	10,062.62
合计		105,941.90	100.00%	105,941.90	100.00%	0.00	103,291.32

上述募投项目调整内部投资结构以及延期事项，系公司根据募投项目实施的具体情况做出的决策，调整均在同一募投项目内部进行结构调整，该等调整有利于募投项目的顺利实施，不构成募投项目变更。

本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂建设项目”，核心定位是服务光伏、锂电及半导体领域，所提供的设备符合国家产业政策，市场前景明确。项目建设将重点满足未来2-3年上述领域的生产需求，包括光伏设备、锂电设备、半导体封装测试设备等产品的组装与调试，并配套机加工园区建设，可有效解决公司当前场地限制问题，为业务拓展提供充足产能支撑。

从实施收益看，项目建成后将打破产能瓶颈，提升公司盈利能力。同时，通过构建规模化、标准化生产基地，将进一步完善产品布局，助力公司优化产品质量、缩短交付周期，强化利润增长点，深化行业竞争力与品牌影响力。在成本控制层面，新建厂房替代租赁场地将减少租赁支出，降低生产负担；集中化办公与生产还将提升集团及事业部间的沟通效率，优化资源调配，降低管理成本，为经济效益增长奠定基础，同时有助于提升企业对外形象与综合实力。后续公司将持续推进项目实施，并密切关注行业政策及市场环境变化，动态优化项目安排，确保实现战略目标，为公司创造经济效益。

2、2022年公司向特定对象发行股票募投项目之高端智能装备研发及产业化项目进度迟于计划，具体情况如下：

（1）TOPCon电池设备项目：TOPCon技术近年来迭代较快，公司对原项目计划进行重新论证及进一步优化，决定增加TOPCon-钙钛矿叠层方向核心设备样机的研发投入，项目预计完成日期延期至2026年8月。

（2）半导体封装测试核心设备项目：受益于AI的快速发展，半导体封装设备迭代加速。为提高募投项目的效益，公司在原研发计划基础上进行重新论证及优化，增加在功率器件、光通讯方面的应用，并进一步完善方案设计中产品性能指标。截至目前，装片机已完成研发并结项，倒装芯片键合机和金铜线键合机已有样机在客户端验证及优化中，根据当前募投项目研发设计方案及募集资金的使用情况，预计该募投项目的实际资金投入低于预算，公司正根据后续等待合适的募集资金使用于更适合市场需求的封装设备的研发，以持续完善公司高端半导体装备产业布局，夯实半导体装备业务发展根基。

3、2022年公司向特定对象发行股票募投项目之“科技储备资金”项目：受行业技术迭代等因素影响，公司主要产品的市场需求发生变化，部分关键技术的研发学习需调整方向和承诺需投入时间超出预期，为保证募集资金发挥应有价值和作用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，增加公司核心产品的竞争力，公司审慎选择对外战略投资、技术合作研发等方向，综合考虑资金使用情况、实际项目进度等影响，拟将项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年8月，并根据项目实际实施进度投入募集资金。

4、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目进度迟于计划，具体情况如下：

（1）平台化高端智能装备智慧工厂项目：由于“平台化高端智能装备智慧工厂”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素；同时，公司对原有的软硬件配套方案进行了优化调整，导致项目整体进度较计划有所延后。此外，本募投项目的募集资金使用进度较低主要系项目建设规模较大，为保障工程质量、进度及资金安全等，公司控制付款进度，仍有部分工程款等尚未支付。目前该项目预计完成日期延期至2026年8月。

（2）光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目：鉴于光伏行业技术迭代速度较快，该项目此前规划的部分设备已不适用于最新的光伏技术，需结合技术发展趋势重新评估，故目前该项目的设备购置及实验进展低于预期。公司将在原计划基础上探索新的技术路线及实验室功能，配置更适合未来光伏技术的设施。

（3）半导体先进封装光学检测设备研发及产业化项目：该项目在产品概念阶段投入时间比预期时间长，整体进展不及预期；为精确定位产品，满足客户具体需求和功能，提升产品优势以及竞争力，目前项目仍在持续完善研发方案设计中。结合半导体先进封装光学检测设备高分辨力智能光学系统与高性能检测算法的实现难度与资金使用情况，公司将进一步加强研发投入，加快项目推进，并将项目预计完成日期延期至2027年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为，奥特维管理层编制的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奥特维2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1：

2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司　截止至2025年12月31日　单位：人民币万元

募集资金净额				52,447.17		本年度投入募集资金总额					4,988.46		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					35,031.13		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更（含部分变更）	变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
高端智能装备研发及产业化	是		29,000.00	29,000.00	29,000.00	4,763.94	-24,236.06	16.43%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
科技储备资金	不适用		15,000.00	15,000.00	15,000.00	224.52	-14,775.48	1.50%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充铺底流动	不适用		8,447.17	8,447.17	8,447.17	0.00	-8,447.17	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用		52,447.17	52,447.17	52,447.17	4,988.46	-47,458.71	9.51%	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、高端智能装备研发及产业化项目进度迟于计划，主要系： （1）TOPCon电池设备项目：TOPCon技术近年来迭代较快，公司对原项目计划进行重新论证及进一步优化，决定增加TOPCon-钙钛矿叠层方向核心设备样机的研发投入，项目预计完成日期延期至2026年8月； （2）半导体封装测试核心设备项目：受益于AI的快速发展，半导体封装设备迭代加速。为提高募投项目的效益，公司在原研发计划基础上进行重新论证及优化，增加在功率器件、光通讯方面的应用，并进一步完善方案设计中产品性能指标。截至目前，装片机已完成研发并结项，倒装芯片键合机和金铜线键合机已有样机在客户端验证及优化中，根据当前募投项目研发设计方案及募集资金的使用情况，预计该募投项目的实际资金投入低于预算，公司正根据后续等待合适的募集资金使用于更适合市场需求的封装设备的研发，以持续完善公司高端半导体装备产业布局，夯实半导体装备业务发展根基。 2、“科技储备资金”项目：受行业技术迭代等因素影响，公司主要产品的市场需求发生变化，部分关键技术的研发学习需调整方向和承诺需投入时间超出预期，为保证募集资金发挥应有价值和作用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，增加公司核心产品的竞争力，公司审慎选择对外战略投资、技术合作研发等方向，综合考虑资金使用情况、实际项目进度等影响，拟将项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年8月，并根据项目实际实施进度投入募集资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用，参见“三、2025年度募集资金实际使用情况”中的“（三）募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用，参见“三、2025年度募集资金实际使用情况”中的“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	存放于募集资金专户和用于购买理财产品，截止报告期末，理财产品余额0.00万元，具体参见“三、2025年度募集资金实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	适用，参见“三、2025年度募集资金实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”												

附表2：

2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司　截止至2025年12月31日　单位：人民币万元

募集资金净额				113,291.32		本年度投入募集资金总额					16,770.36		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					45,248.37		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更（含部分变更）	变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
平台化高端智能装备智慧工厂	不适用		103,291.32	103,291.32	103,291.32	36,643.18	-66,648.14	35.48%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
光伏电池先进金属化工艺设备实验室	不适用		6,000.00	6,000.00	6,000.00	749.02	-5,250.98	12.48%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
半导体先进封装光学检测设备研发及产业化	不适用		4,000.00	4,000.00	4,000.00	378.16	-3,621.84	9.45%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-		113,291.32	113,291.32	113,291.32	37,770.36	-75,520.96	33.34%	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、平台化高端智能装备智慧工厂项目：由于“平台化高端智能装备智慧工厂”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素；同时，公司对原有的软硬件配套方案进行了优化调整，导致项目整体进度较计划有所延后。此外，本募投项目的募集资金使用进度较低主要系项目建设规模较大，为保障工程质量、进度及资金安全等，公司控制付款进度，仍有部分工程款等尚未支付。目前该项目预计完成日期延期至2026年8月。 2、光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目：鉴于光伏行业技术迭代速度较快，该项目此前规划的部分设备已不适用于最新的光伏技术，需结合技术发展趋势重新评估，故目前该项目的设备购置及实验进展低于预期。公司将在原计划基础上探索新的技术路线及实验室功能，配置更适合未来光伏技术的设施。 3、半导体先进封装光学检测设备研发及产业化项目：该项目在产品概念阶段投入时间比预期时间长，整体进展不及预期；为精确定位产品，满足客户具体需求和功能，提升产品优势以及竞争力，目前项目仍在持续完善研发方案设计中。结合半导体先进封装光学检测设备高分辨力智能光学系统与高性能检测算法的实现难度与资金使用情况，公司将进一步加强研发投入，加快项目推进，并将项目预计完成日期延期至2027年12月。												
变更募投项目情况	公司于2024年10月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》，同意公司调整TOPCon电池设备项目实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限，以及半导体封装测试核心设备项目实施内容。 其中，TOPCon电池设备项目增加TOPCon-钙钛矿叠层方向核心设备的研发投入，并结合实施主体的技术积累情况调整样机建设数量，增加设备购置金额10,000.00万元，调整后金额为30,000.00万元，新增资金需求公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金出资投入，项目完成时间延期至2026年8月。此外，根据调整后投资计划，公司将向无锡普乐提供的有息借款调整为2,400.00万元，具体金额根据项目实际资金投入情况予以确定。 半导体封装测试核心设备项目增加金铜线键合机等在半导体功率器件（如SiC功率器件）以及先进封裸块等方向的应用开发，用于进行客户样机、量产机台设备等。同时根据实际项目情况，公司将向无锡普乐提供的有息借款调整为0.00万元。 半导体封装测试核心设备项目增加金铜线键合机等在半导体功率器件（如SiC功率器件）以及先进封裸块等方向的应用开发，用于进行客户样机、量产机台设备等。同时根据实际项目情况，公司将向无锡普乐提供的有息借款调整为0.00万元。 公司于2024年10月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》，同意公司调整TOPCon电池设备项目实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限，以及半导体封装测试核心设备项目实施内容。 其中，TOPCon电池设备项目增加TOPCon-钙钛矿叠层方向核心设备的研发投入，并结合实施主体的技术积累情况调整样机建设数量，增加设备购置金额10,000.00万元，调整后金额为30,000.00万元，新增资金需求公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金出资投入，项目完成时间延期至2026年8月。此外，根据调整后投资计划，公司将向无锡普乐提供的有息借款调整为2,400.00万元，具体金额根据项目实际资金投入情况予以确定。 半导体封装测试核心设备项目增加金铜线键合机等在半导体功率器件（如SiC功率器件）以及先进封裸块等方向的应用开发，用于进行客户样机、量产机台设备等。同时根据实际项目情况，公司将向无锡普乐提供的有息借款调整为0.00万元。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	高端智能装备研发及产业化项目进度迟于计划，主要系： 1、TOPCon电池设备项目：TOPCon技术近年来迭代较快，公司对原项目计划进行重新论证及进一步优化，决定增加TOPCon-钙钛矿叠层方向核心设备样机的研发投入，项目预计完成日期延期至2026年8月； 2、半导体封装测试核心设备项目：受益于AI的快速发展，半导体封装设备迭代加速。为提高募投项目的效益，公司在原研发计划基础上进行重新论证及优化，增加在功率器件、光通讯方面的应用，并进一步完善方案设计中产品性能指标。截至目前，装片机已完成研发并结项，倒装芯片键合机和金铜线键合机已有样机在客户端验证及优化中，根据当前募投项目研发设计方案及募集资金的使用情况，预计该募投项目的实际资金投入低于预算，公司正根据后续等待合适的募集资金使用于更适合市场需求的封装设备的研发，以持续完善公司高端半导体装备产业布局，夯实半导体装备业务发展根基。												

证券代码：688516　证券简称：奥特维　公告编号：2026-036

转债代码：118042　转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月12日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

此项议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（三）审议通过《关于公司2